

**ТУННЕЛЬНАЯ ИОНИЗАЦИЯ
ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ ФОСФОРА
В КРЕМНИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 4.2 К**

Охонин С. А., Французов А. А.

Предложен новый метод для изучения кинетики ионизации мелких донорных примесей в сильном поле при температуре 4.2 К, позволяющий производить измерения при больших характерных временах ионизации.

Исследовалась кинетика ионизации атомов фосфора в кремнии. Зависимость скорости ионизации от электрического поля и температуры свидетельствует о туннельном механизме ионизации. Измеренная экспериментально величина туннельной константы $E^* = 2.1 \times 10^5$ В/см существенно меньше теоретической $3 \cdot 10^5$ В/см.

При температурах ниже 10 К термическая ионизация атомов фосфора, бора и других легирующих примесей в кремнии происходит чрезвычайно медленно, и основными механизмами ионизации примесей являются туннельная ионизация в сильном поле и ударная ионизация при наличии носителей, инжектированных с контактов.

В ряде работ [1-4] изучался ток, связанный с туннельной ионизацией электронов с уровня мелкой примеси в зону проводимости. Такой метод дает возможность изучать ионизацию только в сравнительно больших электрических полях ($\sim 2 \cdot 10^4$ В/см), когда постоянная времени ионизации меньше 100 нс; кроме того, требуются образцы с низкой концентрацией легирующей примеси ($\sim 10^{13}$ см $^{-3}$), чтобы снизить вклад ударной ионизации в измеряемый ток. В настоящей работе использована другая методика. Изучалась ионизация атомов фосфора в эпитаксиальной пленке, нанесенной на сильно легированную подложку. На поверхности пленки изготавливался р-канальный МОП транзистор (рис. 1). Сильное ионизирующее поле в пленке создавалось при подаче импульсного напряжения между подложкой и каналом транзистора. Ионизация атомов фосфора приводит к накоплению положительного заряда в пленке. В результате изменяются плотность заряда в канале и ток транзистора, изменение тока от времени зависит от кинетики ионизации примесей.

Зонная диаграмма до приложения смещения к подложке показана на рис. 2, а. На поверхности имеется инверсионный канал, а в приповерхностной области доноры, находящиеся выше уровня Ферми, полностью ионизованы. В момент, когда на подложку подается импульсное напряжение, в слабо легированном эпитаксиальном слое возникает добавочное электрическое поле, которое вначале однородно (рис. 2, б). Такая ситуация неравновесна, и через некоторое время происходит ионизация еще некоторой части доноров (рис. 2, в).

Плотность заряда подвижных дырок в канале Q может быть выражена следующим образом:

$$Q = \epsilon_0 \epsilon_s E_s - \epsilon_0 \epsilon_{ox} E_{ox} = \epsilon_0 \epsilon_{ox} |E_{ox}| - \epsilon_0 \epsilon_s |E_s|, \quad (1)$$

где ϵ_{ox} и ϵ_s — диэлектрические постоянные окисла и кремния, E — поле в изолирующем окисле, E_s — поле в кремнии на границе с каналом. Мы считаем, что координата x растет в глубь полупроводника. При этом E_s и E_{ox} отрицательны. При ионизации доноров в эпитаксиальной пленке $|E_s|$ возрастает. В результате уменьшаются Q и соответственно ток в канале транзистора.

Измерения тока канала производились на переменном сигнале (рис. 1) по падению напряжения на сопротивлении R_s , включенном в цепь истока. Это напряжение усиливалось, и сигнал подавался на вход синхронного детектора. Сигнал на входе синхронного детектора измерялся при помощи АЦП. Управление установкой и обработка результатов осуществлялись при помощи ЭВМ. Кри-

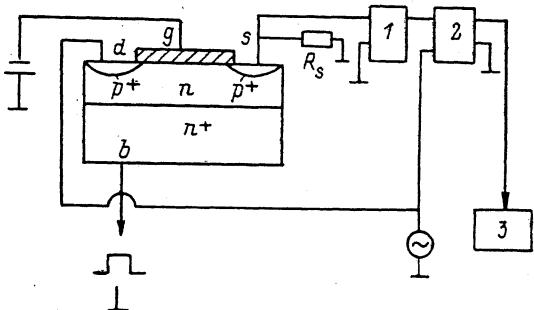


Рис. 1. Принципиальная схема измерений.

1 — усилитель, 2 — синхронный детектор,
3 — аналого-цифровой преобразователь.

вая $J(t)$, измеренная при $T=4.2$ К, показана на вставке к рис. 3. Начальный скачок тока обусловлен изменением заряда в канале вследствие возрастания поля на границе с инверсионным слоем в момент включения импульса. Дальнейшее изменение тока связано с изменением электрического поля на этой границе вследствие ионизации примесных атомов в эпитаксиальной пленке.

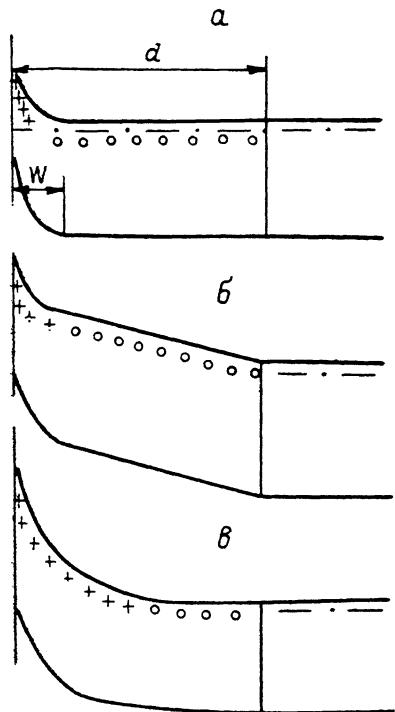


Рис. 2. Зонные диаграммы до (a), в момент (б) и после (в) приложения смещения к подложке.

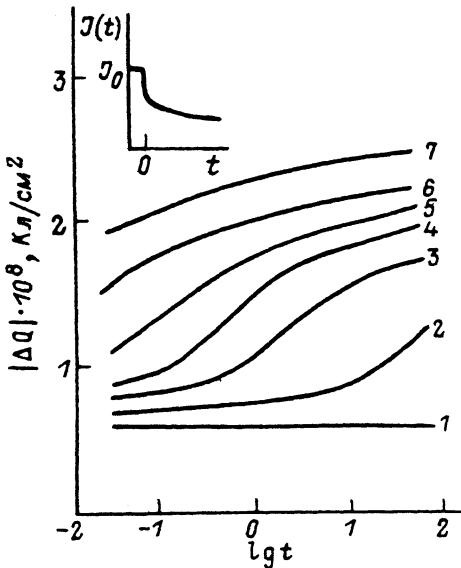


Рис. 3. Экспериментальные зависимости $|\Delta Q|$ от $\lg t$ при разных амплитудах смещения подложки.

Амплитуда смещения, В: 1 — 1.5, 2 — 2, 3 — 2.2, 4 — 2.4, 5 — 2.6, 6 — 2.8, 7 — 3.

В случае слабой зависимости подвижности носителей в канале от смещения подложки, что хорошо выполнялось в наших экспериментах, для расчета зависимости изменения заряда в канале от времени $\Delta Q(t)$ можно воспользоваться формулой

$$\Delta Q(t) = (J(t) - J_0)(Q_0/J_0),$$

где J_0 — ток до подачи смещения на подложку, $J(t)$ — ток после подачи смещения на подложку, $Q_0 = C_{ox} (V_g - V_T)$, где C_{ox} — емкость подзатворного диэлектрика, V_g — напряжение на затворе, V_T — пороговое напряжение.

Транзистор, использованный в наших экспериментах, был изготовлен на эпитаксиальной пленке толщиной 2.5 мкм с концентрацией фосфора 10^{15} см^{-3} , выращенной на подложке с концентрацией доноров $3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$.

На рис. 3 показаны зависимости $|\Delta Q|$ от $\lg t$, измеренные при разных амплитудах импульса на подложке. Наблюдается резкая зависимость кинетики ионизации от величины электрического поля, характерная для туннельного механизма. В то же время в диапазоне 4.2—7 К не наблюдалось зависимости скорости ионизации от температуры, что также свидетельствует в пользу туннельного механизма.

Был проведен расчет изменения ΔQ от времени для туннельного механизма ионизации. Вероятность ионизации в единицу времени [1]

$$\tau^{-1} = A \exp(-E^*/E), \quad (2)$$

где E — электрическое поле, величина параметра E^* определяется туннельной прозрачностью барьера. Для кулоновского потенциала [5]

$$E^* = \frac{4}{3} \frac{\sqrt{2m^*} E_d^3}{q\hbar}. \quad (3)$$

Здесь E_d — энергия основного уровня донорной примеси, m^* — эффективная масса электрона, q — заряд электрона, \hbar — постоянная Планка.

Предэкспоненциальный множитель A в (2) близок по величине к E_d/\hbar и слабо зависит от E .

Величина электрического поля в каждой точке эпитаксиальной пленки может быть найдена из решения уравнения Пуассона

$$\frac{\partial E(x, t)}{\partial x} = \frac{q}{\epsilon_0 \epsilon_s} N_d^+(x, t), \quad (4)$$

где N_d^+ — концентрация ионизованных доноров. Ее изменение во времени подчиняется уравнению

$$\frac{\partial N_d^+(x, t)}{\partial t} = \frac{N_d(x) - N_d^+(x, t)}{\tau(x, t)}, \quad (5)$$

где $N_d(x)$ — полная концентрация доноров на расстоянии x от границы.

Границочное условие при решении уравнений (4), (5), (2) состоит в том, что разность потенциалов между каналом и подложкой после подачи импульса V_b составляет $V_b + V_1$, или

$$-\int_0^d E(x, t) dx = V_b + V_1, \quad (6)$$

где d — толщина эпитаксиальной пленки, V_1 — падение потенциала в слое обеднения и инверсии до подачи импульса.

Интегрирование уравнения (4) с учетом (6) дает для величины поля на расстоянии x от канала

$$E(x, t) = -\frac{V_b}{d} + \frac{q}{d\epsilon_0 \epsilon_s} \left(\int_0^x N_d^+(x, t) x dx - \int_x^d N_d^+(x, t) (d-x) dx \right) + E_1(x), \quad (7)$$

где $E_1(x)$ — поле в слое обеднения до подачи импульса. До включения импульса V_b доноры ионизованы в области обеднения толщиной W и нейтральны в остальной части пленки, т. е. при $W < x < d$. Отметим, что поле $E_1(x)$ равно нулю при $W < x < d$, т. е. в той части пленки, где доноры нейтральны и идет процесс ионизации.

Воспользовавшись выражением (1), можно получить следующее соотношение для изменения заряда носителей в канале:

$$\Delta Q(t) = \Delta E_s(t) \epsilon_0 \epsilon_s = -|\Delta E_s(t)| \epsilon_0 \epsilon_s, \quad (8)$$

где $\Delta E_s(t) = E(0, t) - E(0, 0)$ — разность между полем у границы канала в момент времени t и до подачи импульса смещения на подложку. Величина $E(0, t)$ определяется соотношением (7). С учетом того, что в области $0 < x < W$ все доноры ионизованы еще до подачи смещения на подложку и поле, создаваемое ими, не зависит от времени, для $\Delta E_s(t)$ получим

$$\Delta E_s(t) = -\frac{V_b}{d} - \frac{q}{\epsilon_0 \epsilon_s d} \int_{W'}^d N_d^+(x, t) (d - x) dx. \quad (9)$$

Электрическое поле в момент включения одинаково при всех $W < x < d$ и равно $E_0 = -V_b/d$, скорость накопления заряда, согласно (5), пропорциональна $N_d(x)$ в этой части пленки. Однако по мере увеличения $N_d^+ |E|$ растет в приповерхностной области и уменьшается на границе с подложкой. В резуль-

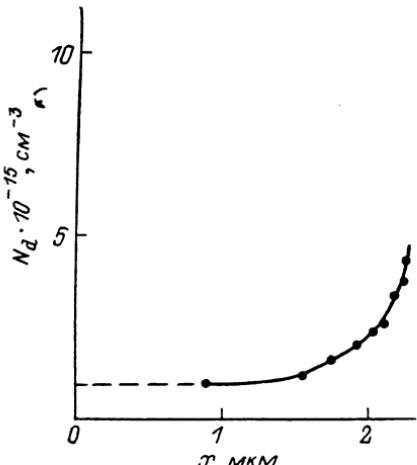


Рис. 4. Измеренная зависимость $N_d(x)$.

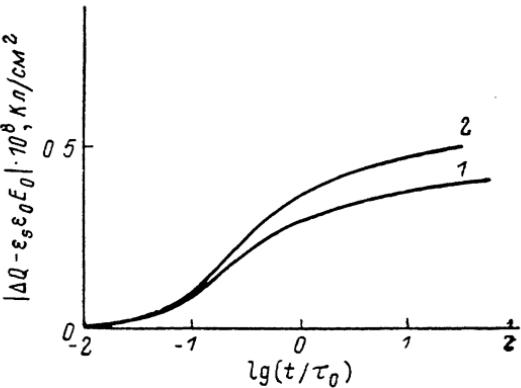


Рис. 5. Расчетные зависимости величины $|\Delta Q - \epsilon_s \epsilon_0 E_0| \cdot 10^6, \text{ кДж/см}^2$ от $\lg(t/\tau_0)$.
 $E_0 \cdot 10^{-4}, \text{ В/см}: 1 - 1, 2 - 1.2.$

тате вероятность ионизации τ^{-1} увеличивается в приповерхностной области, а вдали от поверхности уменьшается. Таким образом, зависимость заряда в пленке от времени имеет сложный вид и не описывается аналитически.

Для численного решения уравнений (4) и (5), описывающих накопление заряда, необходимо знать d и распределение концентрации примесей по глубине $N_d(x)$.

Для определения эффективной толщины эпитаксиальной пленки транзистор охлаждался до 4.2 К. Затем на подложку подавалось синусоидальное напряжение амплитудой δV_b и измерялась амплитуда переменной составляющей тока канала δJ_b при постоянном малом напряжении на стоке. Затем синусоидальное напряжение тех же амплитуды и частоты подавалось на затвор и снова измерялась переменная составляющая тока канала δJ_g . Отношение $\delta J_b / \delta J_g$ равно отношению емкости подложка—канал и емкости затвор—канал, т. е.

$$\delta J_b / \delta J_g = C_b / C_{ox}$$

По измеренной величине C_b / C_{ox} и по известным величинам толщины диэлектрика и диэлектрических постоянных диэлектрика и кремния была определена толщина эпитаксиальной пленки (2.5 мкм).

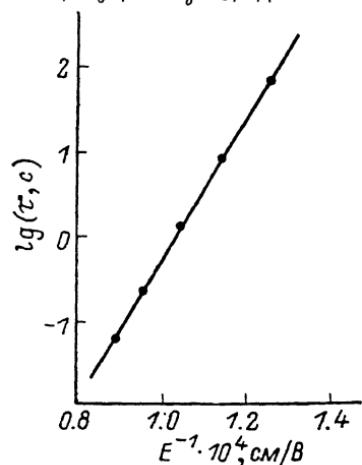
Для определения профиля легирования эпитаксиальной пленки был использован также емкостный метод. Для этого при комнатной температуре измерялась емкость слоя обеднения C_d в зависимости от напряжения на подложке V_b способом, описанным выше.

Далее уровень легирования был найден, согласно [6], по формуле

$$N_d = \frac{1}{\epsilon_s \epsilon_0 q} \frac{C_d^3}{(d C_d / d V_b)}.$$

Определенная таким образом зависимость $N_d(x)$ показана на рис. 4.

Расчетные зависимости $|\Delta Q - \varepsilon_0 \varepsilon_0 E_0|$ от $\lg t$, полученные для данного распределения примесей, показаны на рис. 5. Величина $|\Delta Q - \varepsilon_0 \varepsilon_0 E_0|$ — это та часть изменения заряда в инверсионном канале, которая обусловлена ионизацией примесей в приповерхностном слое. Из расчета следует, что после начального линейного во времени нарастания величины $|\Delta Q - \varepsilon_0 \varepsilon_0 E_0|$ ее рост быстро замедляется уже через время $t=0.1 \tau_0$ [где τ_0 дается выражением (2) при $E = |E_0| = V_b/d$], дальнейшее возрастание идет по логарифмическому закону



На начальном участке график зависимости $|\Delta Q - \varepsilon_0 \varepsilon_0 E_0|$ от $\lg t$ не изменяет своей формы при увеличении импульсного напряжения, а только сдвигается по оси $\lg t$ в соответствии с изменением τ_0 , и по зависимости этого сдвига от $1/E$ можно определить константу E^* в (2). Экспериментальные зависимости имеют качественно такой же вид, однако величина изменения $|\Delta Q - \varepsilon_0 \varepsilon_0 E_0|$ в эксперименте больше, чем в расчете. Разница связана, по-видимому, с каким-то вторичным процессом. Было проанализировано влияние ударной ионизации донорной примеси электронами, возникшими в результате туннель-

Рис. 6. Зависимость τ от E^{-1} .

ной ионизации. Ударная ионизация может увеличить $|\Delta Q - \varepsilon_0 \varepsilon_0 E_0|$ не более чем на 2 %, что не может объяснить наблюдаемого различия в расчетной и экспериментальной величинах.

Из данных рис. 3 можно найти зависимость величины от электрического поля. При вычислении τ предполагалось на основании расчета, что $|\Delta Q - \varepsilon_0 \varepsilon_0 E_0| = 2 \cdot 10^{-8} \text{ К/см}^2$ при $t=0.3\tau$. На рис. 6 показана зависимость $\lg \tau$ от $1/E$, полученная таким образом. Точки хорошо ложатся на прямую в соответствии с (2). Величина E^* , найденная из наклона графика, составляет $2.1 \cdot 10^6 \text{ В/см}$. Она меньше расчетной, получаемой из (3) при $E_d=0.045 \text{ эВ}$, $m^*=0.2$, составляющей $3 \cdot 10^6 \text{ В/см}$. Такое же различие было обнаружено ранее в работах Даргиса и др. [4] для ориентации (111). В их экспериментах $E^*=(2 \div 2.6) \cdot 10^6 \text{ В/см}$ при теоретической величине $3.4 \cdot 10^6 \text{ В/см}$. В настоящий момент неясно, чем обусловлено уменьшение туннельной константы E^* по сравнению с ее расчетным значением. Возможно, что оно связано с искажением туннельного барьера из-за влияния нейтральных примесей в кремнии, концентрация которых может достигать 10^{18} см^{-3} [7]. При такой концентрации на пути туннелирования электрона с донорного уровня, длина которого в поле 10^4 В/см составляет $\sim 500 \text{ \AA}$, должно встретиться несколько примесных нейтральных атомов, что может существенно увеличить вероятность туннелирования.

Авторы приносят благодарность В. М. Ногину за предоставленные образцы.

Список литературы

- [1] Даргис А., Жураускас С. // Лит. физ. сб. 1984. Т. 24. № 6. С. 64—74.
- [2] Даргис А., Жураускас С. // ФТП. 1984. Т. 18. В. 4. С. 595—599.
- [3] Даргис А., Жураускас С., Жураускаене Н. // Лит. физ. сб. 1987. Т. 27. № 3. С. 322—332.
- [4] Dargys A., Matulionis A. // Sol. St. Electron. 1988. V. 31. N 31. P. 717—722.
- [5] Ландау Л. Р., Либниц Е. М. Квантовая механика. М., 1974. 752 с.
- [6] Wu C. D. // IEEE Trans. Electron. Dev. 1975. V. 22. N 2. P. 319—322.
- [7] Болотов В. В., Васильев А. В., Двуреченский А. В. и др. Вопросы радиационной технологии полупроводников. Новосибирск, 1980. 256 с.